

최고의 메카니즘과 융복합기술을 추구하는 IT부품업체를 선도하는 기업

Fine
M·Tec

EV
Foldable Display
Hinge Module
Mobile

THE INVESTOR RELATIONS OF FINE M-TEC 2023

Nov. 28, 2023

KOSDAQ 441270 FINE M-TEC CO.,LTD. 2023 © All Rights Reserved

DISCLAIMER

본 자료에 포함된 회사의 재무성과에 대한 모든 정보는
한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 연결 기준으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 “예측정보”를 포함하고 있습니다.
이러한 “예측정보”는 그 성격의 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 “예측정보”에 명시적
또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것이며,
당사는 명시적/암묵적으로 본 자료와 해당 내용의 정확성이나 완성도에 대하여
어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

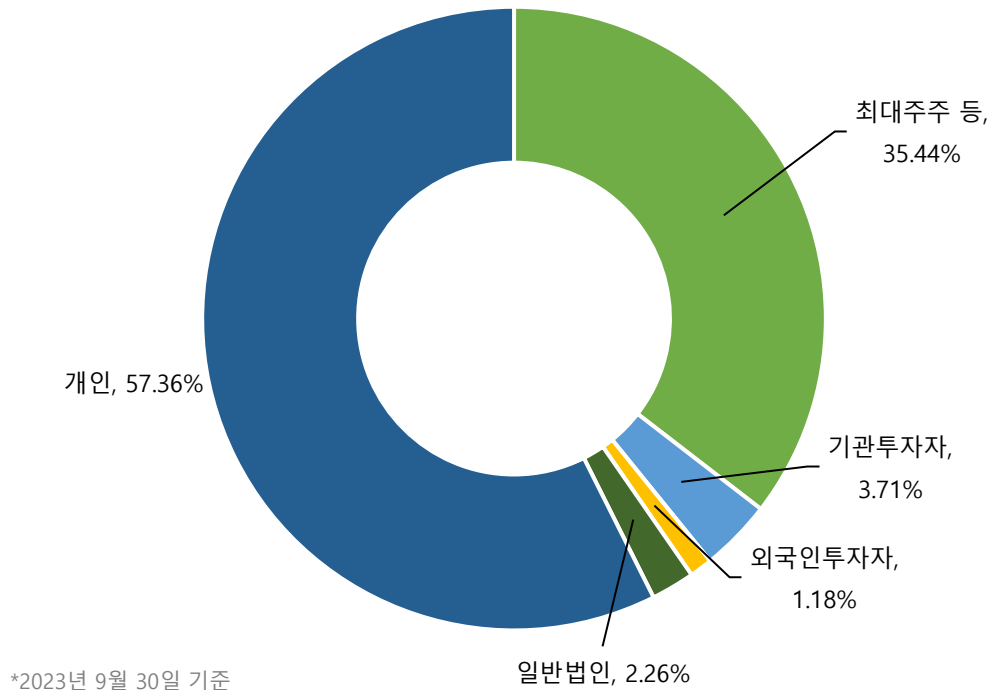
회사개요 및 주주구성

회사개요

회사명	주식회사 파인엠텍
대표이사	이 재 규
설립일	2022년 9월 1일 *주식회사 파인테크닉스로부터 인적분할 설립
상장일	2022년 10월 7일
자본금	18,210 백만원
직원수	국내 130명, 해외 1,800명
사업영역	기구부품 제조(폴더블폰 부품, 자동차 부품 등)
본사주소	경기도 안양시 만안구 전파로24번길 93, 파인엠텍
홈페이지	https://finemtec.com

*상기사항은 2023년 9월 30일 기준이며, 별도의 표시가 없는 경우 연결기준입니다.

주주구성



*2023년 9월 30일 기준

회사연혁

연혁

- 1992 회사설립 ((주)파인디앤씨)
- 1996 삼성전자 LCD총괄(現 삼성디스플레이) 협력사 등록, 벤처기업 인증
- 2000 회사이전 : 경기도 안양 (안양동 203-9,10 / 現 ㈜파인테크닉스 제1공장)
- 2001 공장증설 : 경기도 안양 (안양동 203-3 / 現 ㈜파인테크닉스 제2공장)
- 2008 모바일 IT힌지부품 개발·양산 (슬라이더블,폴더블)
- 2009 (주)파인테크닉스 인적분할 설립 (경기도 안양) - LED조명 및 IT부품 제조, 코스닥 상장
- 2012 다이캐스팅 공정 구축완료(Al, Mg, Zn)
- 2013 다이캐스팅 양산 개시 (자동차 및 IT부품)
- 2014 베트남 현지법인 "FINE MS VINA" 설립 (베트남 박닌 소재)
- 2018 베트남 현지법인 "FINE MS VINA" 2공장 증축
- 2019 폴더블폰 부품 개발 완료 및 고객사 단독 납품 개시
- 2020 (주)파인테크닉스 본점 신규사옥 이전 (안양시 만안구)
- 2021 베트남 현지법인 "VINA CNS"설립 (베트남 박닌 소재)
- 2022 **인적분할 예비심사 승인 및 증권신고서 효력발생**
(분할기일: 9월1일, 존속: LED조명사업(파인테크닉스) / 신설: IT부품사업(파인앰텍)
 화성사업장 이전 확장 (EV부품 주력생산)
- 2023 "VINA CNS"법인 3공장 착공 (EV부품 및 힌지 사업 확장)



파인엠텍의 현재와 미래를 이끌어갈 세 가지 주요 비즈니스 모델을 소개합니다.

폴더블 디바이스, 2차전지 등 정밀기구부품 사업분야 다각화로 사업 포트폴리오 구축

**Fine
M-Tec**

EV
Foldable Display
Hinge Module
Mobile

EV Module Housing

EV시장의 급부상 속에서
파인엠텍의 차세대 성장동력

01

Multi Plate Ass'y

독보적 기술력과
선두주자로서 핵심역량 발휘

02

Hinge Module Ass'y

탁월한 금속 성형 기술력으로
폴더블 기구 부품의 최고의 제조 파트너로 도약

03

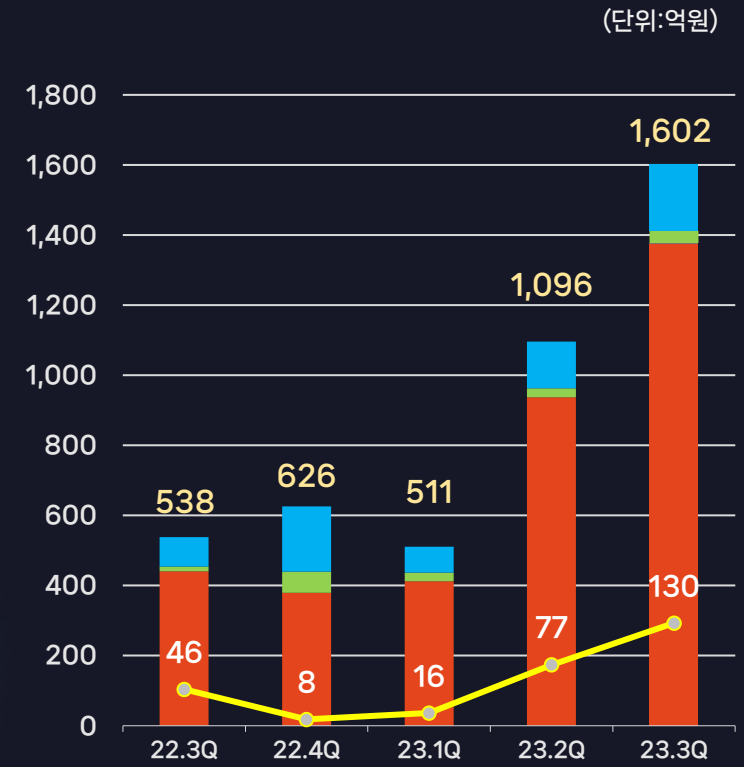
매출 및 영업이익 실적

2024년 폴더블 힌지 기구부품(Hinge Module Ass'y) 및 2차전지 기구부품(EV Module Housing)부문 본격 확장



- Multi Plate Ass'y
- Hinge Module Ass'y
- EV Module Housing
- 기타 (모바일 기구부품 등)
- 영업이익

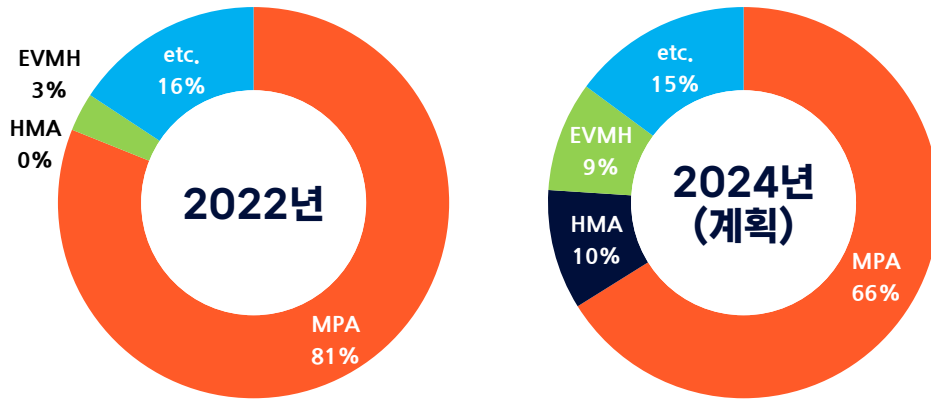
- 폴더블 스마트폰 및 전기차 시장의 급속한 성장 동향에 따른 매출상승 전망
- 태블릿·노트북 등 다양한 폴더블 디바이스 확산 기대



2024년부터 Hinge Module Ass'y(HMA) 및 EV Module Housing(EVMH)부문 매출 증대전망

사업부문별 매출비중

.....▶ 기술력 강화 및 사업다각화로 성장과 지속경영 도모



신규 아이템 매출비중 점진적 증가 예상

- Multi Plate Ass'y
- Hinge Module Ass'y
- EV Module Housing
- 기타 (모바일 기구부품 등)

사업다각화

신사업 도약으로 매출 다변화 전략(계획)

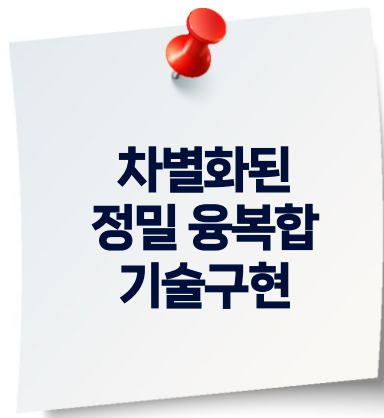
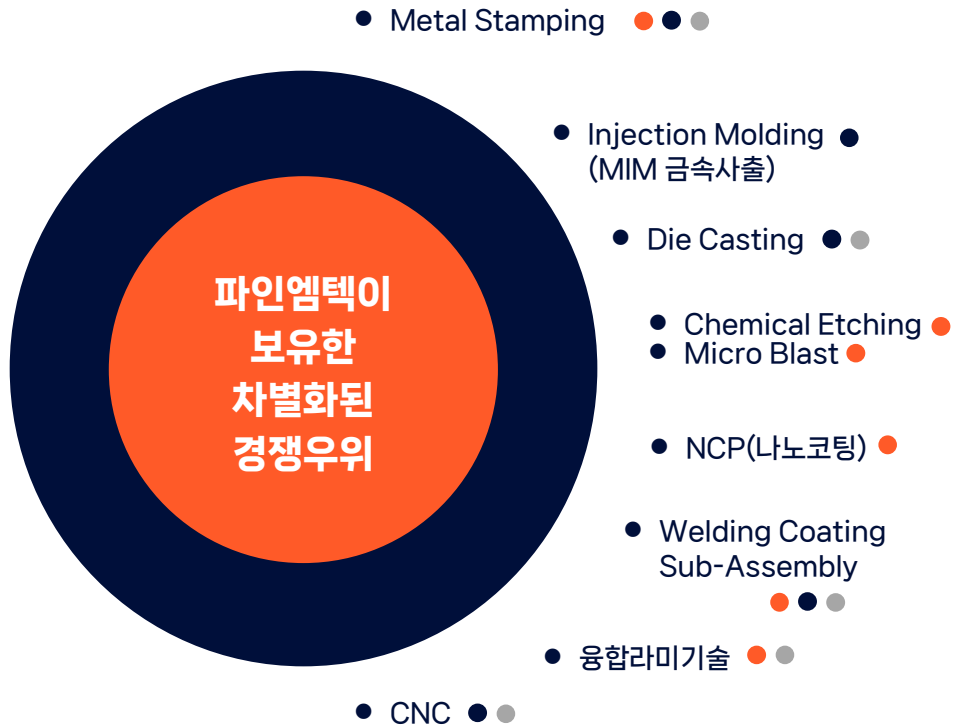
- Multi Plate Ass'y 2023E 80% ▶ 2024E 66%
- Hinge Module Ass'y 2023E 1% ▶ 2024E 10%
- EV Module Housing 2023E 4% ▶ 2024E 9%

기술력 강화

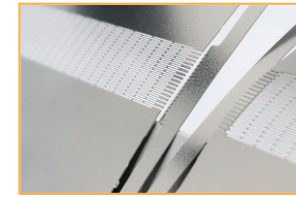
- 다양한 형태의 폴더블 디바이스 개발역량 강화
- EV Module Housing 기구부품 아이템 확대
- 공정 자동화 설계 역량강화
- 원가절감 및 수율 향상으로 수익성 증대

핵심보유기술

다양한 기구부품·모듈을 공급할 수 있는 융복합 제조기술 보유



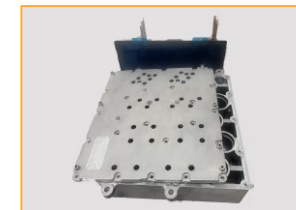
- Multi Plate Ass'y
- Hinge Module Ass'y
- EV Module Housing



Multi Plate Ass'y



Hinge Module Ass'y



EV Module Housing

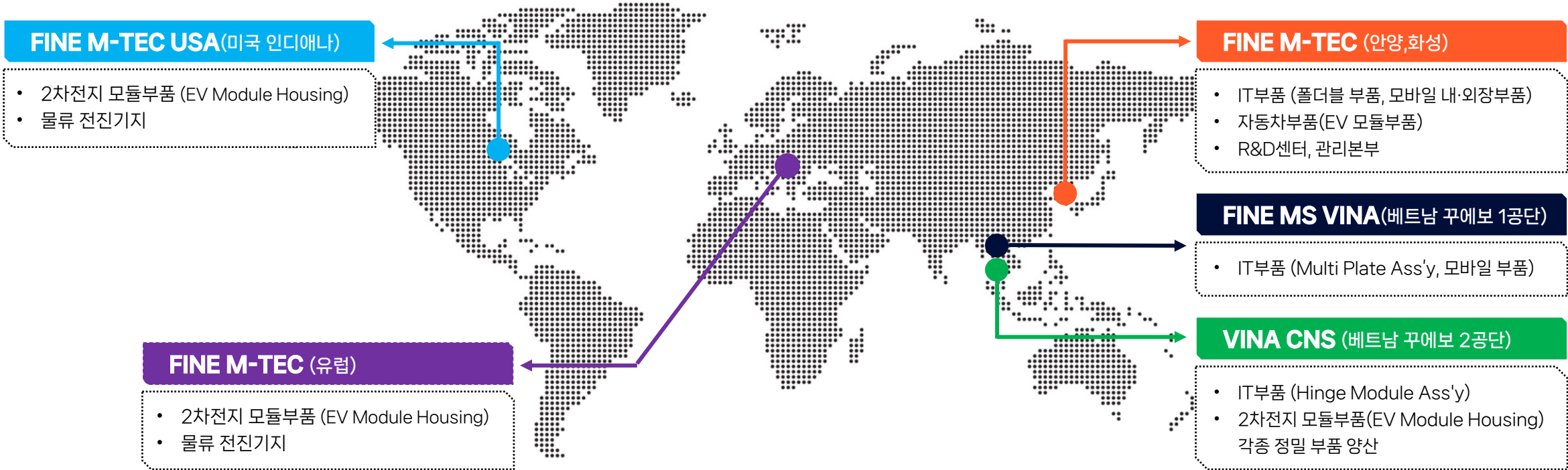


*이미지 출처: 삼성전자



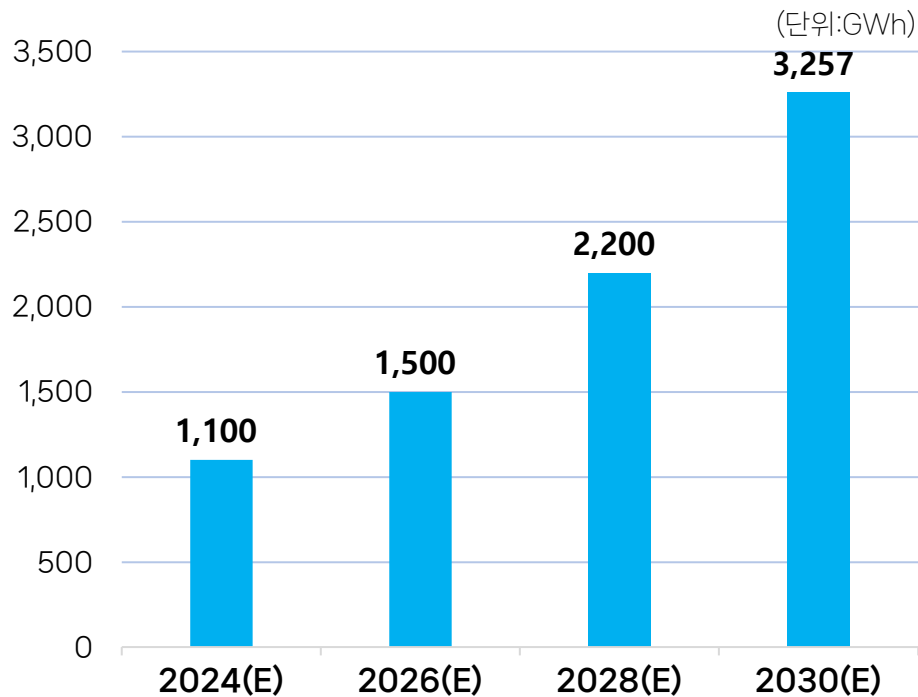
글로벌 파인엠텍

국내 R&D의 혁신적 기술개발과 해외 생산기지를 통한 전략적 사업확장



EV Module Housing 사업

글로벌 2차전지 시장전망



출처: SNE리서치

- EV Module Housing - EV차량용 2차전지 부품사업부문 진출
- 고객사와의 파트너십으로 '24년부터 본격 매출 반영예정

주요제품

- EV Module Housing - 배터리 셀 고정 · 외부로부터의 충격보호, 배터리 스웰링 시 모듈 전체의 외형과 구조 유지
- PDU(Cooling Block) - AC/DC · HV/LV 컨버터 쿨링 모듈

'24년부터 본격 양산, 2차전지 제조사 납품, 북미 · 유럽 완성차 업체向



EV Module Housing



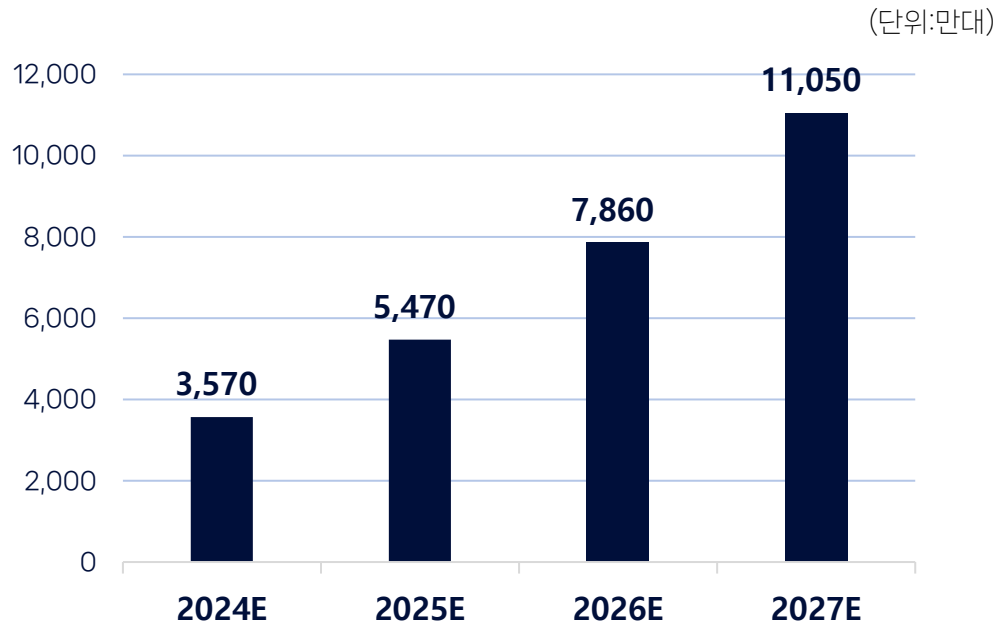
Cooling Block & PDU

Multi Plate Ass'y 사업

폴더블 스마트폰 시장규모 지속 성장 전망

경쟁사 증가로 인하여 다소 M/S감소 예상되나 시장의 성장세와 함께 **"제품다변화에 따른 지속적인 매출증대 예상"**

글로벌 폴더블폰 시장전망



출처: 카운터포인트리서치

주요제품

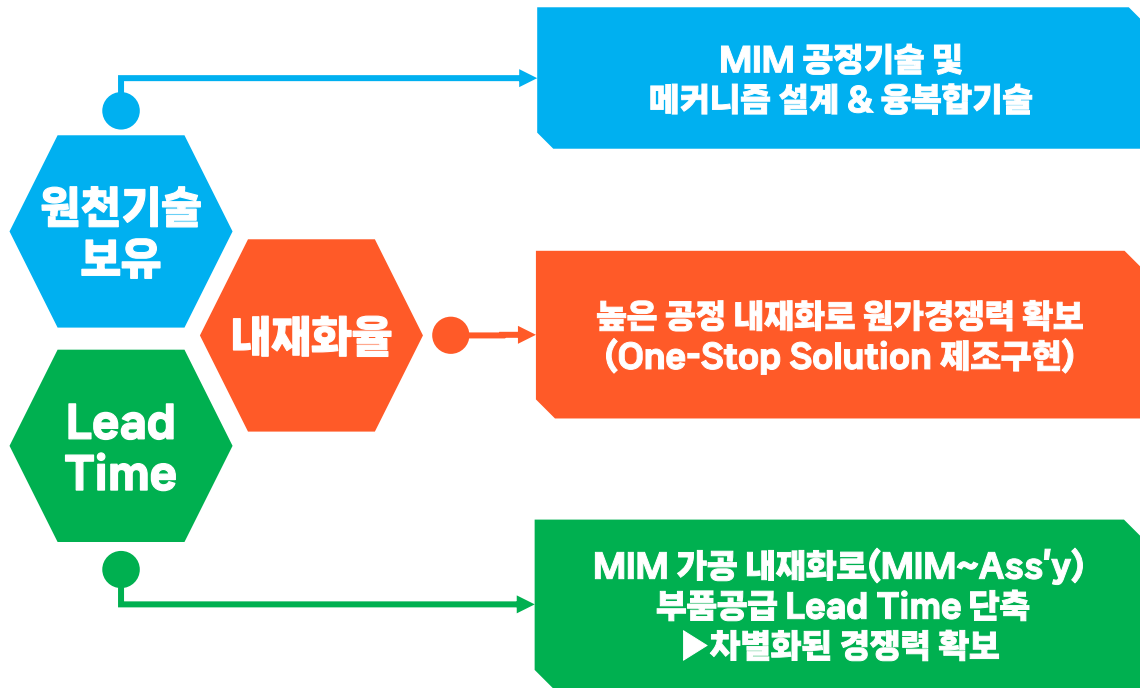
- **Multi Plate Ass'y** - Flexible Display 패널 지지대 역할 및 보호·방열 기능, 패널과 디지털라이저 모듈화
- **폴더블폰 대중화, 적용제품 다변화(태블릿, 노트북 등), 세트메이커 증가에 따른 꾸준한 시장 성장 및 확대 예상**



Hinge Module Ass'y

95%이상 내재화된 공정 및 관련기술 보유로 차별화

내재화된 공정으로 고객사 설계변경·납기 등 빠른 대응 가능하며, 국외 정보유출 등 기술보안측면에서도 경쟁력 우위



Multi Plate Ass'y 와 함께 폴더블 기구부품 전방위 진출
폴더블 기구부품 전문개발·생산업체로 확고한 자리매김 목표

주요제품

- Hinge 모듈 - 삼성 갤럭시 폴더블 모델
뛰어난 내구성과 함께 우수한 폴딩·프리스탑 성능
- '24년부터 본격적인 매출증대 기대



Production Facility



MS VINA 전경 (베트남)



* 3공장 2024년 상반기 완공예정

VINA CNS 전경 (베트남)

MS VINA 시설 소개

- 대지면적 20,000㎡(6,000평)
- Multi Plate Ass'y, 모바일부품 등 생산
- Micro Blast, Forming Press, 사출기 등 설비보유
- 초정밀 Micro Blast기술 및 Laser 공법적용
- 친환경 나노 코팅 표면처리기법을 통한 방열성능 극대화
- 탁월한 Etching 기술로 40μm 정밀도의 금속가공

VINA CNS 시설 소개

- 대지면적 50,000㎡(15,000평)
- Hinge Module Ass'y, EV Module Housing 등 생산
- 금속시트 정밀·고속가공 기술인 메탈스탬핑 공법적용
- 자동화 MIM설비를 통한 제조 최적화
- 자동화조립라인 구축으로 생산성·수율 확보

최고의 메커니즘과 융복합기술을 추구하는 IT부품업계를 선도하는 기업
주주가치를 위해 최선을 다하겠습니다.

THANK YOU

The logo for Fine M-Tec, featuring the word "Fine" in a stylized font above "M-Tec" in a bold, italicized font.

THE **INVESTOR RELATIONS** OF FINE M-TEC 2023